放熱原料セミナー　～熱対策材料サプライヤーとのネットワークの場～

BYK

- ✓ 電子材料、接着剤、セラミックスなど放熱材料の配合処方を検討される技術者様限定
- ✓ 協賛の放熱原料（フィラー、樹脂）サプライヤーの製品紹介を横断的に聞ける
- ✓ 配合設計者のサンプル入手の機会
- ✓ 各原料サプライヤーとの個別面談やサンプル相談を通じて、今後の情報入手、効率的な製品評価が期待できる　　など、対面ならではのユニークなプログラムです。

参加費無料
お申込み要

プログラム	概要
製品説明 午前	各原料サプライヤーによる製品プレゼンテーション 1社あたり30分（Q&A含む）
12:10~13:30	自由昼食、お名刺交換、ご相談
個別面談 15:00~17:00	(参加者　任意選択）当日引いていただく整理券番号で各社毎に順番に面談へご案内いたします。 (自由解散)

■日時：2025年**11**月**5**日(**水**)10:00~17:00
(15:00~17:00は任意の個別面談)

■会場　**TKP新橋カンファレンスセンター**　ホール13C
〒100-0011　東京都 千代田区内幸町1-3-1 幸ビルディング
TEL：03-5510-1351
★個別面談・相談は各社別の会議室　または、13Cホール個別エリア

■申込方法:下記リンクから参加登録をしてください。
リンク　https://forms.office.com/e/RHVbms3fs6__
詳細セミナープログラムは、10月29日頃にemailをお送りしご案内します。

■申込期限:10月28日(火)
★限定数のため、アカデミック・研究機関、商社および、営業、企画、購買業務ご担当者様はご参加していただけません。

主催：ビックケミー・ジャパン（株）ビジネスディベロプメント
協賛：各原料サプライヤー

事務局：ビックケミー・ジャパン（株）マーケティングサービス
お問合せ　Marketing.BYK.Japan@altana.com　　TEL:06-4797-1456

原料サプライヤー　（協賛）
デンカ株式会社、古河電子株式会社、堺化学工業株式会社
東洋アルミニウム株式会社、株式会社MARUWA、
日本軽金属株式会社

ビックケミー・ジャパン株式会社　（主催）
BYK – 添加剤のエキスパート
BYKの革新的な添加剤および差別化された課題解決策は、
お客様の製品・材料の性能ならびに生産工程を最適化します。